

全倒装miniCOB小间距引领新型显示技术

产品名称	全倒装miniCOB小间距引领新型显示技术
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

伴随着小间距销售市场全面爆发，市场对于多层超清要求的提高，LED显示器封装形式从产业链诞生之初单一的DIP（直插式），到今天已经发展成为DIP、SMD、IMD、COB等几种封装形式并行的市场格局。COB是一种多LED灯珠一体化无支撑架封装工艺，直接把LED发亮[集成电路芯片](#)在PCB板里，省去了繁琐复杂表贴加工工艺，没了支架电焊焊接脚，每一个像素的LED芯片和电焊焊接输电线都已经被[环氧胶体](#)密切严密地包裹在胶体溶液内，没有露在外面元素。完成对显示器清晰度部门的色度、色调的氧化性和统一性状态监管，具备低亮高灰、负色、很高的可靠性、led透明屏轻巧等特点。